

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年1月25日(25.01.2024)



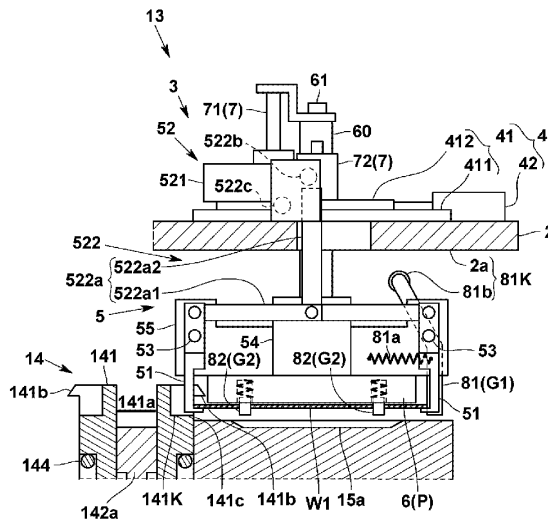
(10) 国際公開番号

WO 2024/018759 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/56 (2006.01) *B29C 45/17* (2006.01)
B29C 45/02 (2006.01) *H01L 21/677* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/020368
- (22) 国際出願日: 2023年5月31日(31.05.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-116957 2022年7月22日(22.07.2022) JP
- (71) 出願人: T O W A 株 式 会 社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 吉 田 周 平 (YOSHIDA, Shuhei);
〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 西村 竜平, 外(NISHIMURA, Ryuhei et al.); 〒6008441 京都府京都市下京区四条町 3 4 7 番地 1 C U B E 西烏丸 9 階 Kyoto (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,

(54) Title: CONVEYING DEVICE, RESIN MOLDING DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING RESIN MOLDED ARTICLE

(54) 発明の名称: 搬送装置、樹脂成形装置、及び樹脂成形品の製造方法



(57) Abstract: A conveying device 13 according to the present invention makes it possible to position a molding target with respect to a pot block having an overhang part, and is for conveying a molding target W1 to a lower mold 15 provided to a pot block 141 having an overhang part 141b. The conveying device 13 is provided with: a substrate holding part 3 for holding the molding target W1; and a holding part transfer mechanism 4 for transferring the substrate holding part 3. The holding part transfer mechanism 4 transfers the substrate holding part 3 toward the pot block 141 in a state where

[続葉有]

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

the molding target W1 is separated from the lower mold 15, and brings the molding target W1 into contact with a lateral surface 141c below the overhang part 141b in the pot block 141. After the molding target W1 is brought into contact with the lateral surface 141c by the holding part transfer mechanism 4, the substrate holding part 3 releases the hold on the molding target W1.

(57) 要約: 本発明は、張り出し部を有するポットブロックに対して成形対象物を位置決めできるようにするものであり、張り出し部141bを有するポットブロック141が設けられた下型15に成形対象物W1を搬送する搬送装置13であって、成形対象物W1を保持する基板保持部3と、基板保持部3を移動させる保持部移動機構4とを備え、保持部移動機構4は、成形対象物W1が下型15から離れた状態で、基板保持部3をポットブロック141に向けて移動させて、成形対象物W1をポットブロック141における張り出し部141bの下の側面141cに接触させ、基板保持部3は、保持部移動機構4により成形対象物W1が側面141cに接触した後に、成形対象物W1の保持を解除する。